

第35回ニューセラミックスセミナー 開催要領

日時： 平成20年2月29日(金) 午前9時45分～午後4時50分
(交流会 午後5時00分～6時30分)

場所： 大阪産業創造館 6階 会議室A・B 大阪市中央区本町1-4-5

主催： ニューセラミックス懇話会・(社)大阪府技術協会

後援： 大阪府立産業技術総合研究所

協賛： 学協会約30団体に依頼

参加費： 主催団体会員 15,000円、協賛団体会員 22,000円、一般 25,000円

定員： 70名 (参加申込締切日 定員になり次第締切)

テーマ： 「セラミックス作製の真髄 スーパープロセステクノロジー」ー粉碎、塗布、積層、焼成ー
<プログラム>

①9:50～10:45

講演題目：ファインセラミックスの成形技術

京セラ株式会社 部品研究開発本部企画部 プロセス設計部責任者 永田 公一 氏

②10:50-11:45

講演題目：ゾル・ゲルコーティング技術の基本的問題：亀裂発生、ストライエーション、アルコール溶媒
関西大学 化学生命工学部 化学・物質工学科 教授 幸塚 広光 氏

③12:45-13:40

講演題目：積層セラミックコンデンサの薄層化技術

株式会社村田製作所 研究開発センター 材料開発統括部 材料2部 担当次長 佐野 晴信 氏

④13:45-14:40

講演題目：インクジェット技術の展開

セイコーエプソン株式会社 次世代プリンティング材料開発グループ 主事 臼井 隆寛 氏

⑤14:50-15:45

講演題目：高品質スクリーン印刷技術

株式会社エスピーソリューション 代表取締役 佐野 康 氏

⑥15:50-16:45

講演題目：セラミックスの高効率プロセスを目指してーコンパクトプロセスの開発

独立行政法人産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 先進焼結技術研究グループ
グループ長 渡利 広司 氏

⑦17:00-18:30 交流会

以上